DIVA Labs.

ECR (Engineering Change Request)

Proposed Change：	☐1. Design modification 設計修改 ☐2. Material change 材料變更 ☐3. Manufacturer change 製造商變更 ☐4. Factory change 工廠變更 ☐5. Process sequency change 工序變更 ☐6. Equipment / Tooling change 設備 / 模具變更 ☐7. Process / Method / Condition change 加工流程/方法 / 條件變更 ■8.Add second source 新增替代料 ☐9. Others 其他：_____	**Initiator：** Tuy 0323 1720
Reason for Change：	Panel Optical Bonding second source change	**EC No：** EC26030701
Model / Part No.：	EPIQ-AUO、EPIQ-AUO, FRU	**Issue Date：** 2026/3/12 **Requester Dept.：** DV11S006
Implementation Type：	■1. Immediately Change 立即切換 ☐2. Running Change 自然切換 ☐3. Other 其他：_____	**Customer Approval：** (confirmed by PM) ☐ Needed ■ Not needed

Material Change Description（Please add pages as needed if the provided space is insufficient.）
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁）

No.	Subassembly		Part No.	Description	Q'ty	Location	Stock	Remark
1	2AAD5390123	B	2AAD539053T	PANEL OPTICAL BONDING,MILDEX,EPIQ,AUO)	1		0	2nd change 1st :2AAD539023T 2nd:2AAD698003T
		A	2AAD698003T	PANEL OPTICAL BONDING,REHEO(RGT2422AMII)	1		5	
		B						
		A						
		B						
		A						

Comments 會簽意見

R&D		Department 會簽部門								Approval
Initiator	Initiator's Direct Supervisor	DQE	PM	Sales	PE	PMC	SCM	PD	QA	R&D Director
Tuy 0312 1000	Michael 0312 1145 Jolly 0312 1140	[illegible] 0312 1140	[illegible] 0312	Estela 0312 1140	[illegible] 0313 1030 [illegible] 0313 1210	Terry 0317 [illegible] 0319	Miy 3/17	[illegible] 0320 Joanne 0319 1600	[illegible] 0320	Michael 0323 1030

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List
工程變更評估項目清單

Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
1. Application for Revision of Specification or Drawing(s) for delivery 是否有修改交貨的規格或圖面	☐Yes ■No need	RD	2AAD539053T 未正式承認，無文件
2. Standards or Regulatories Impact 是否有評估適用之標準或主管機關之相關法規的申請	☐Yes ☑No need	DQE	免評估
3. Change point of PCB mounting PCBA插件位置是否變更	☐Yes ■No need	RD	
4. PCBA Process Changes PCBA製程是否變更	☑Yes (Continue checking below) ☐No	PE	無影响
4-1) Change of Reflow temperature 迴焊溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-2) Change of bonding temperature 膠合溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-3) Change of Manual Soldering temperature 人工手焊工具之溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-4) Change of storage condition after protection humidity package 防潮包裝完成後的儲存條件是否變更	☐Yes ☐No need		
5. Reliability test report (Test result and data) 是否有可靠性測試報告（測試結果及數據）	☐Yes ☑No need	DQE	免評估
6. Process FMEA（Medical only） 是否有進行製程失效模式與效應分析	☐Yes ☑No need	PE	無影响
7. Design FMEA（Medical only） 是否有進行設計失效模式與效應分析	☐Yes ■No need	RD	同等品
8. Risk Management（Medical only） 是否有進行風險管理評估	☐Yes ■No need	RD	同等品
9. Change points due to the modification 是否此修改會延伸導致其他變更點	☐Yes ■No need	RD	

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List
工程變更評估項目清單

Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
10. Initial Supply Control implements plan or result. 是否有實施供料控制評估	☐Yes ☑No need	PMC	
10-1) Confirm the work order or order number or date for the implementation start of the engineering change. 確認工程變更開始實施之工單或訂單號碼或日期。	☐Yes ☑No need		
10-2) Coordinate the handling methods for related products and materials. 協調相關產品及材料處理方法。	☐Yes ☑No need		
10-3) Arrange the production schedule. 處理生產日程之安排。	☐Yes ☑No need		
10-4) Control the changed materials. 變更材料之管制。	☐Yes ☑No need		
10-5) Establish relevant execution control records for EC materials, register traceability data for each material. 建立有關工程變更物料之相關執行管控記錄、登錄各項物料追溯性資料。	☐Yes ☑No need		
11. Training Requirement 若此一變更影響製程或檢驗，是否需要再做人員訓練	☐Yes ☑No need	PE	無影响
12-1. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☐ QC control plan ☐ Service Manual ☐ Others	☐Yes ☑No need	QA	無影响
12-2. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☐ SIP ☑ SOP ☐ Others	☑Yes ☐No need	PE	
12-3. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☑ MDF ☑ DMR ☐ Approval Sheet ☐ Engineering Spec ☐ Others	☑Yes ☐No need	RD / DQE	

tonychen

寄件者: Amber_Tsao <amber_tsao@diva.com.tw>
寄件日期: 2026年3月9日星期一 下午 5:49
收件者: tonychen@diva.com.tw
副本: 'Lily_Chiu'; 'Una_Tsai'; 'Chris_Lu 呂姿葶'; 'tina_chen'; 'Terry_Huang'; 'Hu, Estela (Partner)'; 'RYAN'
主旨: RE: Forecast update_260309

Hi Tony,

請協助為以下兩個機種的 BOM
1A2A24235321600，EPIQ-AUO
1A2A24235321602，EPIQ-AUO, FRU

1. 加入 2AAD698003T，PANEL OPTICAL BONDING,REHEO(RGT2422AMII)
   作為 2AAD539023T，PANEL OPTICAL BONDING,DATA IMAGE,EPIQ_A 的替代
2. 並把 2AAD539053T，PANEL OPTICAL BONDING,MILDEX,EPIQ,AUO)刪除，因 2AAD539053T 已不會再使用

立即導入，不須客戶回簽

若有問題再請告知，謝謝!

Best regards,
Amber Tsao

From: Lily_Chiu <lily_chiu@diva.com.tw>
Sent: Monday, March 9, 2026 5:20 PM
To: 'Una_Tsai' <una_tsai@diva.com.tw>; Chris_Lu 呂姿葶 <chris_lu@diva.com.tw>; Amber_Tsao 嘉雯 <Amber_Tsao@diva.com.tw>
Cc: 'tina_chen' <tina_chen@diva.com.tw>; 'Terry_Huang' <terry_huang@diva.com.tw>; 'Hu, Estela (Partner)' <estela_hu@diva.com.tw>
Subject: RE: Forecast update_260309

Una

設計變更審查會議記錄

時間	20260309	地點	801	主席	Amber
參與人員	Lily_Chiu, Una_Tsai, Chris_Lu, Tina_chen, Terry_Huang ,Hu, Estela, Ryan				

討論與決議事項：

設計變更原因 ：刪除 2AAD539053T, 因已不會再使用

設計變更描述 ：加入 2AAD698003T 作為 2AAD539023T 的替代

導入時程 ：Normal

客戶審查 ：No needed

一. 研發課評估 ：

單位	審查內容	附加文件
EE :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
FW :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
ME :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
SW :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
DQE :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無

二. 結論 ：

1.開發單位各部門評估後,此設計變更不會對產品預期用途造成影響,

功能	設計變更內容無關功能影響
性能	設計變更內容, 無關產品性能影響
可用性	無影響, 沒有使用上的風險
安全性	組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險,
法規	經審查, 沒有影響法規內容

2.發行 ECR

人員簽到：